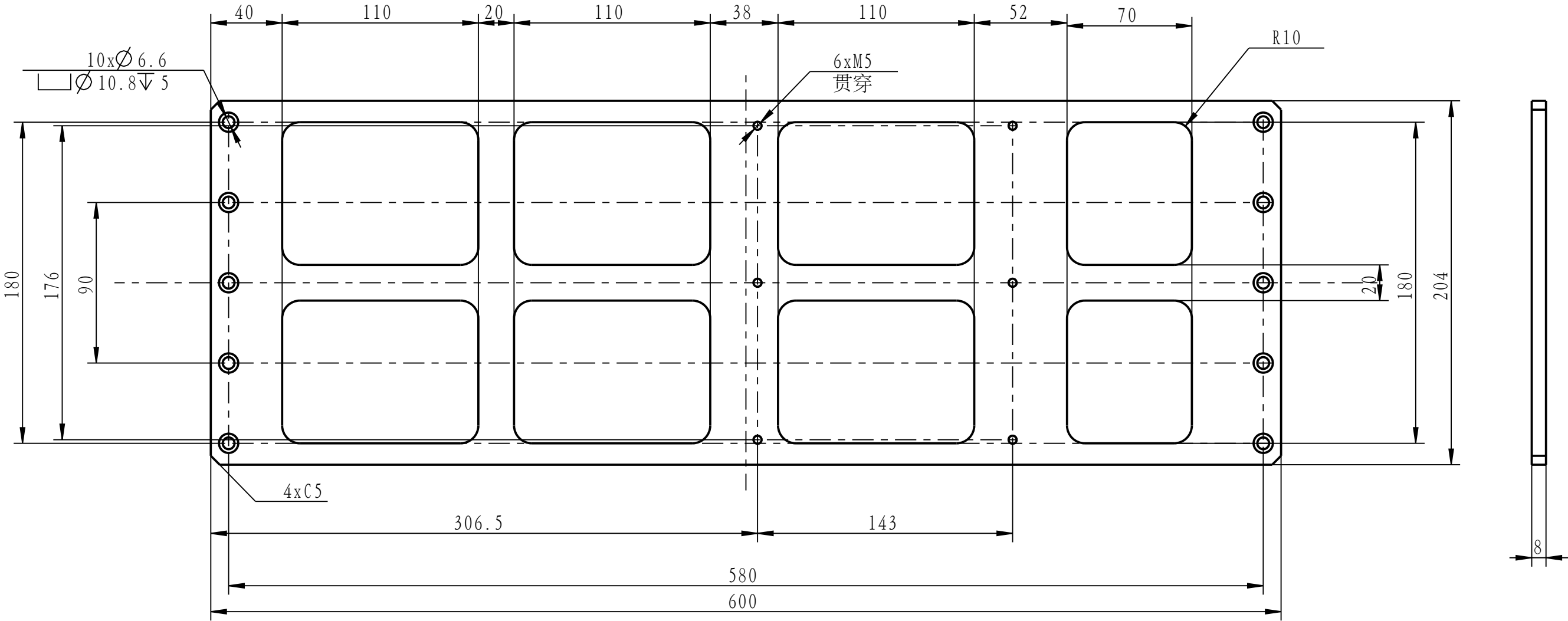


密级:	表面处理	激光膜
	热处理	

F2_040401_552000_07

合图

其余 $Rz3.2$ (✓)



旧底图总号

底图总号

制 图

签 收

日 期

- 技术要求
1. 未注尺寸按GB/T1804-m, 未注形位公差按GB/1184-K,
 2. 锐边倒角, 去毛刺。

					6061		哈尔滨工业大学	
标记	处数	更改文件号	签字	日期				
设计			会签		重量	3.65	200*100*10假负载转接板 (偏孔)	
校对					件数			
			标准化		比例	2:5	F2_040401_552000_07	
审核			审批		阶段标记	E		
工艺			批准		共 1 张	第 1 张		